

平成28年度 第1回 フジコ・ミーティング資料

日 時： 平成28年 5月20日（金）

場 所： 三次元半導体研究センター 隣接

「社会システム実証センター」 3F セミナー室

ミーティング： 15:00~17:00

- | | |
|-----------|---|
| 1) あいさつ | 1. 「今年度のフジコミーティングについて」
野北 寛太 |
| 2) 講演 | 1. 「L/S=5/5 以下 2.1D、2.5D 対応 有機インターポーザ プロセスの提案」
株式会社 JCU 総合研究所 エレクトロニクス技術開発1部
新城 沙耶加 氏 |
| 3) 研究進捗報告 | 1. 「TSV プロセスを基本とした開発技術」
光富 久光
2. 「部品内蔵基板プロセスの開発技術」
林 繁宏 |